

## 日月光一〇四年度第三季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 104 年 10 月 29 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇四年度第三季獲利報告，本公司一〇四年第三季之合併營業收入較一〇四年第二季成長 4%，較一〇三年同期成長 9%，為新台幣 72,870 百萬元。茲將日月光一〇四年度第三季單季及前三季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

### 合併綜合損益表（單位：新台幣百萬元）

項 目	104 年度 第三季	104 年度 第二季	103 年度 第三季	104 年度 前三季	103 年度 前三季
營業收入淨額	72,870	70,222	66,632	207,754	179,947
營業毛利	12,987	11,566	14,208	36,866	37,178
營業淨利（淨損）	6,382	5,409	8,099	18,083	19,799
稅前淨利（淨損）	7,810	5,400	8,605	18,716	18,969
所得稅利益（費用）	(1,127)	(1,596)	(1,240)	(3,579)	(2,791)
非控制權益	(315)	(152)	(148)	(648)	(405)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	6,368	3,652	7,217	14,489	15,773
基本每股盈餘(新台幣元)	0.83	0.48	0.94	1.89	2.05
稀釋每股盈餘(新台幣元)	0.69	0.43	0.82	1.76	1.98

### 綜合損益表 - 半導體封裝測試（單位：新台幣百萬元）

項 目	104 年度 第三季	104 年度 第二季	103 年度 第三季	104 年度 前三季	103 年度 前三季
營業收入淨額	39,862	37,671	42,211	116,138	115,828
營業毛利	10,651	9,504	12,082	30,150	30,934
營業淨利（淨損）	5,644	5,101	7,361	16,291	17,569
稅前淨利（淨損）	7,433	5,229	8,381	17,892	18,228
所得稅利益（費用）	(1,016)	(1,537)	(1,108)	(3,262)	(2,331)
非控制權益	(49)	(40)	(56)	(141)	(124)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	6,368	3,652	7,217	14,489	15,773

### 半導體封裝測試銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	55
電腦	11
汽車, 消費性電子及其它	34
前十大客戶佔營收比重	53

銷售地區別佔比	%
北美	63
歐洲	10
台灣	17
日本	5
亞洲其它地區	5

封裝業務產品組合	%
Advanced Packaging	34
IC Wirebonding	56
Discrete and Others	10
封裝資本支出金額	83 百萬美元
打線機台數	15,617 台

測試業務產品組合	%
後段測試	76
晶圓測試	20
前段測試	4
測試資本支出金額	25 百萬美元
測試機台數	3,417 台

### 電子代工服務銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	56
電腦	13
消費性電子	19
工業用	7
汽車電子	4
其它	1
前十大客戶佔營收比重	92
EMS 資本支出金額	24 百萬美元

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光公司 2015 年第四季的業績展望如下：

- 半導體封測事業之產能持平而產能利用率下滑 4%到6%;
- 半導體封測事業之毛利率應與1Q15水準相近;
- 電子代工服務之產能持平而產能利用率應上升 14%到16%;
- 電子代工服務毛利率應接近2Q15水準。